

對中國武漢市三選科技有限公司 及販售其產品的兩家台灣代理商 提起晶片背面保護膠帶的專利侵權訴訟

2026 年 9 月 17 日，琳得科向台灣新北市的智慧財產及商業法院，分別對位於中國的晶片背面保護膠帶製造商——武漢市三選科技有限公司（以下稱「三選科技公司」），以及販售其產品的台灣代理商——熱力應用材料有限公司與研展科技股份有限公司提起專利侵權訴訟，請求停止製造及販賣等（以下稱「本案訴訟」）。

本公司認為，三選科技公司所製造的晶片背面保護膠帶，侵害了本公司所擁有之晶片背面保護膠帶相關台灣專利第 I516530 號、第 I634187 號、第 I833953 號及第 I542659 號專利權（以下稱「本案專利」），進而提起本案訴訟。

本案專利涉及應用於 Wafer Level Chip Scale Package（WLCSP）的重要技術，截至 2026 年 6 月，本公司在包括台灣、中國、韓國、菲律賓及新加坡在內的 8 個國家及區域，累計持有之晶片背面保護膠帶相關專利已達 600 件以上。本案訴訟中，三選科技公司涉嫌侵權的產品如下：

- CTB-EV6
- CTB-EV6X2
- CWB-SEHW
- CTD-EK1225
- CTD-EK0825
- CTB-EV6R-HT

本公司致力於透過開發滿足客戶需求的獨創產品持續提升企業價值，並將智慧財產權視為重要的經營資源。本公司基於以下方針推動智慧財產權相關活動，本案訴訟亦為該活動的一環。

- 於基礎事業領域及成長事業領域建構專利組合
- 尊重他公司之智慧財產權
- 針對侵害本公司智慧財產權之第三人，採取包含行使權利在內的適當措施

本公司將持續密切關注本案訴訟的進展，並視情況評估是否進一步行使權利，包含對其他專利侵權行為提起訴訟等。